

御 得 意 様 各 位

ケミカルマテリアル Japan2022 出展のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社はこのたび オンライン展示会「ケミカルマテリアル Japan 2022」にて、プリント配線板、半導体ウエハに対応した表面処理薬品および関連機器を紹介いたします。

是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。

敬具

記

日 時：2022年10月17日(月)~10月28日(金)
会 場：下記 URL フォームより来場登録をお願いいたします。
<https://www.chemmate.jp/>

【出展品】

①Lucent Copper PVF

パターンめっきに対応したビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤です。優れたビアフィル性能を有し、薄いめっき膜厚でも効果的に BVH を充填します。微細回路の膜厚分布に優れており、パッド部や微細配線などの面積の異なるパターンの膜厚を均一化します。

②Lucent Copper IVF

ビアフィル性能に優れ、オーバーフィルを効果的に抑制する為、エニーレイヤーなどのビルドアップ基板に適した硫酸銅めっき添加剤です。液流の影響を受けにくく、様々な攪拌条件においても一定のフィリング性能と膜厚均一性を実現します。

③Melstrip SE-400

MSAP に対応した銅シード層エッチング液です。極薄銅箔による銅シード層のエッチングに最適です。平滑な銅表面と矩形な回路が得られるため、伝送損失の低減に寄与します。

④Melstrip DF-3870

超微細回路から厚膜に対応したドライフィルム剥離剤です。銅の溶解を抑制する為、微細な銅回路を維持したままドライフィルムの剥離を行うことができます。また厚膜のドライフィルム剥離性に優れており、長時間の浸漬でも銅ピラーを溶解しません。

⑤Melplate NI-869A / Melplate Pal-6500 / Melplate AU-7770

メルプレート NI-869A は耐熱性に優れたニッケルめっき皮膜であり、UBM 形成後の熱履歴や高温動作下におけるクラック発生等

の問題を抑制します。膜厚均一性にも優れ、UBM 品質の安定化に寄与します。

メルプレート Pal-6500 および AU-7770 はニッケルめっき皮膜上にパラジウムおよび金皮膜を形成するためのめっき液であり、下地ニッケル皮膜を溶解することなく接合層を積層することが可能です。

⑥多段式電解殺菌装置 CMS シリーズ

貯蔵タンク内の純水等をコンパクトな電解式殺菌装置に循環させることで効率よく制菌（殺菌）し、藻やバイオフィルムの発生を抑制することが可能な装置です。UV 殺菌装置では処理の難しい植物性微生物に対しても効果的です。

既存もしくは新設の循環ラインに挟み込んで設置するだけで使用可能です。